

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



## 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	长江证券 杨洋 蔡少东；华商资金：邱凯、金曦； 东方红资管 廖家瑞；景顺长城：农冰立；博时 基金 冀楠；东方证券：虞圳劬；中融基金：陈 祖睿；民生证券 李萌；前海开源 吴思源
时间	2022年11月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书桑泽林 证券事务代表廖娅伶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请公司介绍一下主营产品与公司其他产品的关联性？下游客户行业的不同是否会使用到不同的公司产品？</p> <p>公司生产的微电子焊接材料及辅助焊接材料主要应用于电子制造过程中的 PCBA 电子装联环节。下游客户主要为拥有自主设计能力，生产销售能力的品牌公司或 OEM、ODM 等代加工企业。</p> <p>PCBA 电子装联工艺主要有 DIP 波峰焊接、SMT 表面贴装、选择性焊接等工艺。通常一个 PCBA 上会有多种工艺制程。锡膏主要应用于 SMT 工艺；焊锡条、助焊剂主要应用于 DIP 工艺；焊锡丝</p>

则一般用于选择性焊接或机器人自动焊接工艺；清洗剂适用于回流炉、波峰焊等设备和治具的清洗，同时也适用于钢网、焊后 PCBA 的清洗等工艺。因此，公司的产品主要围绕解决 PCBA 中各种电子装联工艺下的焊接、助焊、清洗等功能场景。公司的核心经营模式也是向电子制造业客户提供电子装联的整体解决方案。

随着物联网、5G 通讯、大数据等行业发展趋势，电子产品正经历不断的升级换代，下游客户对电子装联环节的导电、散热、防水防潮、防静电等电气性能都提出了更高的要求，这使得电子材料需不断向精细化、绿色化、低温化等技术方向发展。该趋势有利于公司在未来长期保持较高的产品附加值，拥有较高的盈利水平。未来，公司将继续围绕 PCBA 电子装联环节，丰富核心产品线，为客户提供一站式综合解决方案。

## **2: 电源连接器、接线盒上用锡膏是否与普通 PCB 用锡膏一样？是否有特殊要求？**

电源连接器、接线盒用锡膏，在合金上与普通 PCB 上用锡膏不同。同时其焊接工艺也有所不同。

## **3: 半导体和芯片用锡膏主要应用在那个生产环节？**

半导体和芯片的封装工艺是要实现晶圆和电路的焊接，主要有锡膏，焊片和银胶（浆）等焊接方式，当前高功率的半导体器件主要采用的都是锡膏和焊片焊接，锡膏更容易实现连续作

业，生产效率高，成本也更具优势。

#### 4、目前行业壁垒主要体现在哪些方面呢？

(1) 技术与工艺壁垒，微电子焊接材料行业属于技术密集型行业，涉及材料、物理、化学、机械、电子、自动控制等多个学科的交叉综合应用，而成熟的产品配方体系往往需要多年的积累，并且随着通讯、消费电子等下游行业的快速发展，势必要求微电子焊接材料更新换代速度不断加快，这对企业研发技术人员具备多种学科知识及掌握上下游行业的综合性学科知识提出了较高要求。

(2) 客户认证壁垒，作为电子材料行业的重要基础材料之一，微电子焊接材料的细微变化都可能对终端产品的导电及连接性能产生严重影响，因此下游客户对微电子焊接材料供应商的认证非常严格，知名客户的认证周期通常耗时1至2年。在通过认证后，客户通常还要通过小批量试产对供应商产品的稳定性与服务能力进行审慎评价，部分客户通过长达1至2年小批量验证后才会大批量使用。出于对产品质量稳定性、转换成本等方面的综合考虑，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此客户认证，特别是大客户认证对新进入的企业来说设置了较高的准入门槛。

附件（如有）

日期

2022年11月22日